

編號	競賽組別	隊名	題目	總決賽排名	姓名(隊長)
1	先進製程技術開發組	闕一不可	電漿輔助化學氣相反應技術應用於低溫成長先進二維材料及新興元件之應用	1	郭O玟
2	先進製程技術開發組	TCC LAB	新穎低溫缺陷鈍化技術在半導體元件應用	2	徐O澤
3	先進製程技術開發組	DHLab	先進的可撓性憶阻射頻開關	3	陳O傑
4	新世代半導體應用材料組	ASMC LAB	透過最先進的金屬有機化學氣相沉積技術實現先進二維電子元件的晶圓級異質外延和載流子調控	1	李O玲
5	新世代半導體應用材料組	CSMC吃什麼菜	系統級連續應力開關測試與深度神經網路分析方法研究 $\beta$ -Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> SBD 中的動態肖特基能障	2	王O然
6	新世代半導體應用材料組	Ferrowiz	使用低晶格失配 (2.9%) $\beta$ -W 的均勻且無疲勞的鐵電 HZO	3	廖O聰
7	元件設計開發組	CFET NINJA	適用於人工智慧終端設備記憶體內運算之新穎10T3P奈米片互補式電晶體靜態隨機存儲記憶體	1	姚O旺
8	元件設計開發組	霹靂卡霹靂拉拉	實現高密度全自旋機率計算: 雙模態Top-pSOT-MRAM的設計與開發	2	楊O妤
9	元件設計開發組	請填入隊伍名稱	基於複雜氧化物開發之高速多位元阻式記憶體應用於記憶體內計算技術	3	陳O丞
10	半導體生產製造組	TC group	環境友善明膠剝離製程：增強遠距磊晶的可能性	1	吳O
11	半導體生產製造組	晶準探測者 Precision Explorer	先進封裝製程優化: 基於機器學習的多參數三維量測技術	2	謝O淇
12	半導體生產製造組	發光的蹦蹦蛙-從台南到新竹	透過自注意力卷積神經網路與TabMT合成數據技術提升半導體故障檢測效能	3	陳O霖

## ◆獲獎須知◆

- 一. **競賽獎金**皆**內含稅金**，入帳後為完稅金額，已扣除所得稅。
- 二. 校外同學須先填寫**匯款同意書**，**檢附**相關**文件**、**簽名及存摺正面**(PDF或拍照)，回傳給承辦人，以利清大出納組建置個人資料表。
- 三. 全數資料完成建置後，始得進行美光競賽獎金核銷報支作業。

## ◆溫馨提醒◆

- 一. 請將信件與匯款同意書轉給您的隊員，轉知小組隊員一同填寫  
<https://forms.gle/a2X6M1VpZcz6AL8e6>
- 二. 如，競賽獎金全數入到隊長帳戶，由隊長進行分配發放，須謹記隔年與家人合併申報時，衍生額外增加需繳納所得稅賦，由個人負責。

\*如獎金選擇入隊長個人帳戶，請隊長於Google表單上載明清楚\*